

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成26年12月18日(2014.12.18)

【公開番号】特開2013-258175(P2013-258175A)

【公開日】平成25年12月26日(2013.12.26)

【年通号数】公開・登録公報2013-069

【出願番号】特願2012-131691(P2012-131691)

【国際特許分類】

H 01 L 33/60 (2010.01)

【F I】

H 01 L 33/00 4 3 2

【手続補正書】

【提出日】平成26年10月30日(2014.10.30)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

回路基板上にLEDダイを実装し、該LEDダイを透光性の封止部材で被覆した半導体発光装置において、

前記封止部材は上部に溝を備え、

該溝は前記封止部材の上部全体に亘り、中心部が最も低く、白色部材が充填され、

前記溝と直交する前記封止部材の一対の側面に白色部材を備えている

ことを特徴とする半導体発光装置。

【請求項2】

前記溝がV溝であることを特徴とする請求項1に記載の半導体発光装置。

【請求項3】

前記LEDダイがフリップチップ実装されていることを特徴とする請求項1又は2に記載の半導体発光装置。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0007

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0007】

上記課題を解決するため本発明の半導体発光装置は、回路基板上にLEDダイを実装し、該LEDダイを透光性の封止部材で被覆した半導体発光装置において、

前記封止部材は上部に溝を備え、

該溝は前記封止部材の上部全体に亘り、中心部が最も低く、白色部材が充填され、

前記溝と直交する前記封止部材の一対の側面に白色部材を備えている

ことを特徴とする。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0009

【補正方法】削除

【補正の内容】